第 18 屆中小企業創新研究獎

範例

申　請　書

申請標的名稱：A&F　XXY 對位模組

申請類別	□資訊與電子類 ■機械與自動化類 □材料與生技類 □服務類 □綜合類 （請依據標的物屬性自行勾選申請類別）		
公司名稱	全研科技有限公司		
負責人	邱毓英		
電話	04-8711***		
傳真	04-8711***		
聯絡人	林建男	分機	無

一、申請企業基本資料 【表1】

企業名稱	(中文)全研科技有限公司 (英文)CHIUAN YAN TECHNOLOGY		行業別	□ 製造業 ■ 服務業	
主要營業項目	精密儀器批發業、XY 滑台、微型 Stage、線軌				
統一編號	12754***		設立日期	民國 90 年 02 月 26 日	
公司登記地址	(52245)郵遞區號 彰化縣田尾鄉新興村新興路 371 號		電話/分機	(04)8711***	
			傳真	(04)8711***	
工廠地址 (製造業必填)	(　　)郵遞區號		電話/分機	(　)	
			傳真	(　)	
網址	www.aafteck.com				
聯絡人	林建男	職稱		行動電話	095********
e-mail	Starcraft1979@aandf.com.tw				
企業負責人	(中文)邱毓英 (英文)Rich	職稱	(中文)總經理 (英文) Chief Executive Officer		
研發單位主持人	李浩瑋　博士	職稱	研發部經理		
實收資本額	[redacted]仟元		99 年平均員工人數	**人	
99 年申報營業淨額	[redacted]仟元				
99 年投入研發經費總額	[redacted]仟元				
99 年研發比例 (研發經費總額/營業淨額)	[redacted]% (本項若低於 2.0%不得申請)				

註1：營業淨額係指：營業收入總額減去銷貨退回及銷貨折讓。

註2：研發經費係指用於下列用途之費用：

(1)研發人員人事及培育費用
(2)改進生產及管理技術費用
(3)供研發用之圖書、樣品費用、消耗性器材及原料費用、設備儀器之當年折舊費用
(4)專供研發單位使用建築之折舊費用與租金及維護費用
(5)專為研發而購買的專利權、專門技術及著作權之當年攤折費用
(6)委託大專院校研究機構辦理研究工作之費用
(7)開發新產品之技術及市場調查研究費用
(8)其他經主管機關及財政部專案認定屬研發之費用。

註3：員工人數係依據勞保局99年1~12月核發之「勞工保險局保險費明細」之人數為基準。

二、申請獎勵標的資料說明　　【表2-1】

(一)申請獎勵標的名稱

中文：A&F　XXY對位模組

英文：Alignment　Stage

申請標的物為有形產品者，請將照片貼於此處《電子檔亦可》

如篇幅不足，請自行增加頁數

【表 2-2】

(二)申請獎勵標的說明(包括用途及創新特色)

XXY 故名思義就是有兩個 X 方向的軸向，搭配一個 Y 方向軸向，剩餘一軸採自由軸。它的出現用來取代某些傳統 XYΘ 的應用，不管名稱為何，三軸對位是近年來發展高精密對位的趨勢。在機構的設計上，全研在 2007 通過對位機構的專利，每個軸向皆是一組 XYΘ 模組的縮小版，並積極研發各式平台，在 2008 年更通過薄型大平台對位專利，進行各式平台輕薄化設計，最高對位精度可達 1μm。

全研科技的創新研發是持續性的，從 2007 年起為了因應市場需求的變化，開始將單一零組件變成模組化的形式，直至 99 年底終於在軟體控制上獲得突破。這段期間，全研 XXY 對位模組產品在應用上的成就有目共睹，96 年 1 月 PCB 板曝光機開發量產、97 年 5 月觸控面板 Touch panel 貼合技術(對位精度達 99.5%良率)、 97 年 8 月電組印刷對位、98 年 1 月開發出台灣製第 1 台晶圓曝光機，99 年 4 月使用於壓合對位機構，直至 99 年 12 月全研終於成功將軟體控制技術與 A&F XXY 對位模組作結合，未來應用面除了原先精密產業設備應用、自動送料機、點塗膠設備、檢測設備、雕刻設備外，應用廣度及技術層面應可獲提昇。

下述三項，請詳參附件。

1、 全研 XXY 特色

2、 XXY 動作簡介

3、 共平面結構 XXY 模組結構選定作業流程

如篇幅不足，請自行增加頁數

【表 2-3】

(三)申請獎勵標的研發創新與運用概況(請以文字或數字具體說明)

1. **申請獎勵標的研發創新**

(1)開始於__96__年，完成於__99__年__12__月(* 非99年研發完成之標的不得申請)

(2)已投入研發金額____[redacted]_____元，研發地點：__全研公司____

2.申請標的生產或運用情形：(99 年 1 月 1 日至 100 年 6 月 15 日止)

(1)量產運用於__100__年__1__月____日(指可軟體控制的量產)

(2)生產地點：___全研科技_____

(3)已生產或運用數量: ____[redacted]_____件(申請截止日前)

(4)銷售額:內銷__[redacted]_____元、外銷___0___元(外銷國別:_____)、

銷售額佔公司總營業額比例：__[redacted]__ %(99 年 xxy 平台約 [redacted]%)

(5)申請標的之市場佔有率：國內___[redacted]__%；國外___[redacted]__%(中國大陸)

3. 整體研發概況(以文字具體說明)

「全研科技」創立於 1999 年，設址於彰化縣田尾鄉，目前已擠身成為亞洲「精密對位平台機構規劃製造、創新研發」之專業機構設計品牌。成立至今始終秉持「創新突破」的企業經營理念，在 XXY 系列對位平台、高精密 AD 系列平台、AF 系列精密平台、mini STAGE 系列微型平台、袖珍精密平台、微調手動移動平台、快速移動平台及鎖緊螺帽系列、AF 型 LED 光源系列、高精密零組件等領域中，擁有最先進的客製化設計能力，並堅持以「A&F」品牌在產業中務實深耘，能夠量身打造以滿足客戶的個別化需求，本公司產品力求精準對位的具體展現，已深深獲得客戶長期以來的肯定與支持。

本公司擁有最堅強的研發設計團隊，從單一零組件，到今日模組平台系統及次微米平台設計製造，已擁有相當豐碩之國內外專利認證；為追求卓越研究創新發展，更耗資成立「次微米平台計畫室」、「無塵室」及「恆溫恆濕清淨室」，並積極整合產、學、研各界技術的交流合作，在技術上力求創新精進，以求服務更廣大的客戶面， 目前滑台系列產品已超過上百種，陸續通過 SGS 檢測及多方專利認證。

即時需求回應、充滿活力及優越的服務熱忱，是公司最引以為傲的產品經營優勢。專注創新研發導向，確實增益並協助客戶獲致高度企業價值，是全研科技戮力發展、不斷追求突破的永續經營目標。

*所謂研發地點係指申請標的研發所在(如本公司、工廠或其他合作企業…等)

*所謂生產地點係指申請標的生產所在(如本公司的工廠、委託製造的工廠或其他生產所在地等)

【表 2-4】

(四)申請獎勵標的規劃與執行經過

從單一零組件組裝，到今日模組平台系統及次微米平台設計製造，本公司已擁有相當豐碩之國內外專利認證；更耗資成立「次微米平台計畫室」、「無塵室」及「恆溫恆濕清淨室」，就是為了讓XXY 系列等高精密對位平台，能有更好的精度及穩定度。但是要控制硬體並不是簡單的一件事，尤其在對位的精準度上，會隨著不同應用產業的需求不同而調整，因此本公司於99年成立軟體研發部門，就是為了滿足客戶模組化需求。除了能有效降低客戶的成本外(把控制多個硬體的軟體作整合)，同時在軟體操作亦追求更簡便、更精準的對位需求。目前國內市場上真正能控制XXY平台的廠商並不多，在此之前幾乎都是日本THK等大廠掌握技術而壟斷整個市場，但是本公司創新研製的XXY對位模組，就是為了準備與國外作價格戰的廝殺，在一樣的控制水準下，我們最大的優勢就是能夠把價格壓低一半，逼迫原先大廠在價格上的追進降低，透過客製化的營運模式去滿足每個客戶在硬體設計上的需求，增加軟體控制來提高量測的精準度及穩定度，終至99年12月獲得在模組化過程中獲得關鍵性突破，預估在整個市場將有廣泛性的影響，未來商機跟獲益更是可想而知。

料材買賣→硬體組裝→加工整合→客製設計→軟體研發→模組化--->整機控制

如篇幅不足，請自行增加頁數

【表2-5】

(五)申請獎勵標的獲得/國內外專利權之紀錄

□ **無**

■ **有（請詳填下列表格）**

＊ 請依序檢附相關證明文件影本

已核准

編號	核准國家（請註名國別）	名　稱	日期	證號（非發文號）	取得核准			與申請標的相關（∨）
					發明（∨）	新型（∨）	新式樣（∨）	
	中華民國	[redacted]	2011.2.21-2020.9.13	M398462		✓		✓
	中華民國	[redacted]	2011.4.1-2020.9.13	M401195		✓		✓
	中華民國	[redacted]	2011.4.11-2020.1.7	M401765		✓		✓

尚未核准（包含申請中及公告階段）

編號	申請國家（請註名國別）	申請中（∨）	公告中（∨）	名　稱	日期	發文字號	發明（∨）	新型（∨）	新式樣（∨）	與申請標的相關（∨）

※請說明上述已核准專利與本申請標的之關係

上述三項專利為本公司於99年取得之專利申請，目前尚在專利保護期間。該專利係直接應用於XXY對位模組上。

如篇幅不足，請自行增加頁數

【表2-6】

(六)申請獎勵標的曾獲得國內外得獎紀錄 、標準 、認證 、登記著作權……等之紀錄

□ 無

■ 有（請詳填下列表格）

編號	名　　稱	取得(核准)日期/字號	國名/機構名稱	與申請標的相關（∨）
1	現有專利	詳如附表清單	中華民國	✓
2	無塵室內機械設備動態模擬之微粒子逸散分析	2010.11.18	SGS	

＊請依序檢附相關證明文件影本

如篇幅不足，請自行增加頁數

三、申請獎勵標的評審項目說明 【表3-1】

(一)申請獎勵標的之創新性 （佔評審權重35%)

撰寫重點

1. 同類競爭標的之現況。

2. 與同類競爭標的在創新上之差異。(例如：設計理念、市場/產品成熟度、開發創意等)

3. 本標的之創新程度。(例如：新穎性、創新價值、創新之資訊/網路應用之策略、智慧財產權等)

4. 本標的在安全性及環保等方面之考量。(例如：製程、產品、流程或服務等)

說明：

目前電子設備中，因產品功能愈來愈多，體積愈來愈小，故要求定位精度愈來愈高，體積希望愈輕薄。全研因應市場開發CCD對位平台滿足需求。平台之設計與製作，須顧及精度功能外，更要結構簡單、成本掌控、組裝容易，校正方便，才能有競爭能力。全研目前自行研發之XXY(UVW)對位平台，非XYΘ平台，兼具上述要求且正進入實機應用中，深具好評。目前同類中，最早由日本市場如THK、IKO、NSK…等大廠主導壟斷。由於成本高及專利關係，且一些零組件也由日本控制，國內發展不易。但近年國內一些組件似THK業者，正研發有廠牌之XXY平台，其結構和THK相似，相對其製作成本不是居高不下，且有侵權之虞。另有其他產品，設計上須購買高精度進口零組件，成本一樣相當高。而全研XXY平台，創新設計要點如下:

1、 全研自行開發之Θ組件，自行加工、組裝，體積小且成本低，在精度相近下，具高度競爭能力。

2、 國內大廠以標準十字單座滑軌為組件，相對於全研以雙排VR全支撐滑軌為組件，全研除輕薄外，剛性及精度控制均更上一層樓。

3、 結構簡單，成本降低，全研產品於表面處理、材質油脂選別上不同，更可應用於無塵等級100class之製程設備。

如篇幅不足，請自行增加頁數

【表3-2】

(二)申請獎勵標的之實用性 （佔評審權重35%)

撰寫重點

1. 本標的在產業上的利用價值。(例如:商品化效益、供給需求、客源分析、產業發展示範性、對國內產業發展之關聯性等)

2. 與同類競爭標的在實用上之差異。(例如:實用機能、降低成本、品質提昇、附加價值提高及對市場的衝擊程度等)

3. 本標的在開發低成本量產技術及產品上之程度。

4. 本標的實施後對企業內/外部產生之有形及無形效益及影響。(例如:員工士氣提昇、企業形象、顧客關係的改變、市場的接受度、客訴率、具體效益之預測值比較等)

說明:

在電子設備中如 PCB、LCD、LED、半導體、SMT 封裝、CCD…之對位平台需求量非常大，故產業中之商業應用產值非常高。總和年度需求至少千台模組以上(不含大陸)。全研之 CCD、XXY 對位平台於 LED 晶圓檢測設備上、高精度曝光機、PCB 視覺印刷機、LCD6.5 代和金屬中心共同開發之大面積對位平台，都是應用了相關技術。

我司對位平台因結構簡單，且可單一模組，且可於大小面積之承載平台及負載大小，可選定任意模組數量設計，可延伸之模組或設計設備，可容易應用。且在空間應用上我司整體高度可低於同業，這是設備輕小化一大利基。另因應各種產業設備需求，開發 10 餘種尺寸負載不同 stage 以供客戶選擇。如 LCD6.5 代之 4 支 CCD 及 4 軸 servo 之對位系統平台，才因應而生。

本產品開發至今，和客戶討論亦受益良多，且多作改進，進而對公司內員工作技術研討，提昇公司內技術能量、士氣，且因 CCD 平台之研發，而新增軟體部門，拓展本司機電、軟體整合，增進競爭能力及給客戶一體性技術服務，減少因客戶對本司產品使用不良或軟體搭配整合不良之客訴，無形中更能提高公司形象和公司產值。

如篇幅不足，請自行增加頁數

【表3-3】

(三)申請獎勵標的之國內外競爭力 (佔評審權重20%)

撰寫重點

1. 本標的之國內外競爭力優勢。(例如：市場獨特性、產品生命週期、市場區隔及價格定位、成長能力、國內外需求之有效性等)

2. 本標的之延伸性發展或行銷策略之構想。

說明：

全研之CCD對位模組平台，在國內業界最早發跡，技術已趨成熟，且有軟體搭配成一整體完整成品，將向歐美市場進軍，且對大陸市場已布局設點已有些成效。對於歐美日之產品，成本過高及大陸技術層級並未成熟，我司將具信心開拓國外市場。

因應國內對本司產品了解，我司在策略上與學術界配合，如虎科大、金屬中心、工研院…等學術單位作產學合作，將產品應用於未來設備開發上。

同時本公司於2011年舉辦全研科技論文獎徵文比賽，主題為「多軸精密平台設計」、「影像伺服控制與整合」兩大主題，提昇和學術界對話平台。讓學有專精學生提早認識CCD及對位平台。2012年更提供全研開發之CCD、XXY對位平台計15台給各大專院校作對位軟體開發比賽，提昇學生對設備研發興趣，且為軟體開發墊定基礎，並由專業領域教授及我司具博士學歷之軟體主管給予比賽指導。

如篇幅不足，請自行增加頁數

【表3-4】

(四)申請企業之目前及中長期研發構想及營運　(佔評審權重10%)

撰寫重點

1. 目前之研發概況。(含現行研發組織、設備及人力投入情況、研發計畫之控管作業等)
2. 未來**3~5**年之研發構想。(例如：研發重點、人員、設備、經費配置及投入、外部資源運用、研發策略與方法、預期成果等)
3. 未來營運規劃構想、方向及品牌建立。

說明：

1. 本公司因應市場需求，於 99 年 9 月成立軟體控制與研發部門(部門設備詳如表列)，目前部門人員共計 5 員，由成大航太系畢業的李浩瑋博士及其他 3 位工程師組成(1 碩士，2 學士)。
2. 由於全研公司強調不斷創新突破，而研發更是要跨領域，並非執著於某一領域，需要巧變。全研對於公司內部人員素質的提升非常重視，對於人員的學習或進修補充專業知識相當注重，也常不定期舉辦教育訓練，鼓勵員工進修攻讀碩士、博士，期望公司在未來能在不同的領域裡可以有所發揮。
3. 產業的長久發展與永續經營的條件為專業人才的培養，為了讓公司更多元化發展，目前全研已與國內幾所知名大專院校的教授進行產學合作，公司也提供平台讓學生直接可到公司學習，向下紮根，培養他們的研發條件，並藉此進行職前訓練，若學生表現優良，公司則直接錄取，這對於學生來說不只工作有了保障，更讓全研善盡為國培養人才的經營理念，也達到互惠雙贏的效果。
4. 全研科技長期以來專注在 XXY 對位模組及精密平台技術的提昇，因應未來科技趨勢的發展及脈動不斷在進行調整與修正，以專業超群的客製化能力在產業界占有一席之地，今年更舉辦「第一屆全研科技論文獎徵文活動」，以行動證明全研追求創新的決心。目前第二屆論文獎的活動已積極籌備當中，全研科技將努力去結合中部學術資源及整合大專院校的力量擴大舉辦，目前第二屆的規劃暫定委由建國科技大學工程學院負責承辦。在未來，全研將以產、學、研結盟的方式舉辦論文比賽，期望讓台灣的高科技產業能更精進，對於傳統產業也能將其技術水平提昇。
5. 目前公司的研發重點放在影像處理的部份，對於目前最熱門的行業如 PCB 產業，觸控式面板，LCD 等…進行新型設備的開發，以本公司的精密線性移動平台和 XXY 三軸共平面移動平台為基底，加上 CCD 影像擷取功能、物件識別以及運動學分析的搭配，研發高精度，高速度以及高穩定性的閉回路對位模組系統。公司至 100 年 6 月已完成對位軟體的開發，亦已應用在實機的操作上。
6. 望眼未來 3 到 5 年，全研預計將投入更多的研發心力，除了人員的精進外，對於各式人才的聘僱更會是重點，預期將聘顧電子電路、半導體、生物科技、應力分析等相關領域人才，研發部門至少達到 2 博士、4 碩士、4 學士的目標。
7. 全研在未來將此對位原理運用在生物科技的儀器開發上，利用現在光機電整合的經驗與技術，投入生物科技檢測儀器的開發。另一方面也可以發展高精度的量測系統或是校正系統，讓不論是全研或是其他公司的機台，可獲一定的精度水平，並達到低成本、功能強的效果。
8. 全研公司所有產品不走仿冒路線製造就如同公司名稱「全研」一樣，全是研發團隊投入良多心血所全新研發出來的結晶，且全研不走低價格競爭策略，以經營團隊實實在在的做事精神，堅持以品質與口碑開拓市場，持續落實經營理念的執行。
9. 展望未來，全研公司將持續研發成果提供業界，並朝客戶的全方位需求為努力的目標邁進，全研自許「A&F」平台，成為全球企業界愛用的第一品牌。

如篇幅不足，請自行增加頁數

【表3-5】

企業組織圖(請繪出企業組織圖，並標示出各部門、研發隸屬單位及人員編制)

說明:

詳如附件。

如篇幅不足，請自行增加頁數

四、企業最近3年之整體研發創新概況 【表4】

項目 年份	研發創新重點(註 1)	成效概述(註 2)
97年	XXY 對位平台 PCB 板曝光機 電組印刷對位	1 月取得套筒式轉軸定位裝置新型專利 5 月成立次微米計劃室 6 月參加光電展 7 月取得大尺寸薄型顯示器對位機構新型專利、磁力傳動裝置新型專利 10 月參加 TPCA 展 10 月取得轉動體結構新型專利 10 月取得背隙與間隙消除裝置新型專利
98年	XXY 對位模組 觸控面板 Touch panel 晶圓曝光機	全研科技與高雄金屬中心、永美科技、邦泰科技、美商國家儀器，共同結盟-觸控面板智慧型設備開發聯盟 觸控面板 Touch panel 貼合技術(對位精度達 99.5%良率) 4 月取得多軸調焦裝置新型專利大陸多軸調整裝置新型專利 6 月參加光電展 7 月取得線性滑動單元發明專利 10 月參加 TPCA 展
99年	XXY 對位模組 影像處理 自動控制 機構設計 壓合對位	斥資成立「研發部門」結合平台與軟體模組化套裝整合，亦積極規劃投入擴建二廠及無塵室之建構。 全研科技與高雄金屬中心、美商國家儀器祐暘，共同結盟-壓合對位聯盟 6 月參加光電展 9 月取得大陸多自由度調整裝置新型專利 10 月參加 TPCA 展 10 月參加 TIROS 展 10 月取得線性傳動組背隙消除結構發明專利

註1：研發創新重點部份請具體說明主要構想及項目。

註2：成效部份係指當年開發、上市、取得專利權、標準、認證、參展、提高之附加價值、節省成本、品質良率改善、投資之效益等。

如篇幅不足，請自行增加頁數

五、企業近5年申請政府補助及運用國內研發資源之紀錄　【表5】

(一)政府相關單位補助計畫

附件編號（請依序排列）	執行日期	計畫名稱	機關名稱

(二)學術機構研發資源應用

附件編號（請依序排列）	執行日期	計畫名稱	機關名稱
	96.04.01-96.11.30	[redacted]	金屬工業研究發展中心
	96.09.01-96.11.30	[redacted]	工業技術研究院
	96.09.17-96.12.17	[redacted]	工業技術研究院
	97.01.01-97.12.31	[redacted]	金屬工業研究發展中心
	97.03.07-97.07.31	[redacted]	工業技術研究院
	97.04.01-97.11.30	[redacted]	工業技術研究院
	99.02.01-99.11.30	[redacted]	金屬工業研究發展中心
	100.02.01-100.11.30	[redacted]	金屬工業研究發展中心

如篇幅不足，請自行增加頁數

六、切結書 【表6】

(一)本企業申請第18屆中小企業創新研究獎之**標的**

1. ■ 未曾獲政府機關補助
   □ 已(曾)獲(請勾選)
   - □主導性新產品開發輔導計畫-工業局 □協助傳統產業技術開發計畫-工業局
   - □中小企業即時技術輔導計畫-工業局 □數位內容產業發展補助計畫-工業局
   - □小型企業創新研發計畫-技術處 □業界開發產業技術計畫-技術處
   - □創新科技應用與服務計畫-技術處 □協助服務業研究發展輔導計畫-商業司
   - □創新技術研究產學合作-國科會科學園區
   - □高科技設備前瞻技術發展計畫-國科會科學園區
   - □農業生物技術研發成果產業化計畫-農委會
   - □促進農業企業研發輔導計畫-農委會
   - □創新產品獎-國科會科學園區
   - □研發成效獎-國科會科學園區
   - □國家發明創作獎-智慧局
   - □中小企業創新服務憑證補助-中小企業處
   - □其 他_____(請填寫)

   □ 申請中_____(請填寫)

2. ■ 未曾獲政府機關獎項獎金
   □ 已(曾)獲_____獎獎金
   □ 申請中_____(請填寫)

(二)本企業符合中小企業認定標準 (請擇一勾選)

‧製造業、營造業、礦業及土石採取業

□ 實收資本額在新臺幣8,000萬元以下之企業

□ 實收資本額在新臺幣8,000萬元以上，經常僱用員工人數未滿200人之企業

‧其他(前項規定外之其他行業)

□ 99年營業額在新臺幣1億元以下之企業

■ 99年營業額在新臺幣1億元以上，經常僱用員工人數未滿100人之企業

(三)99年研發比例等於或高於2.0% ■ 是 □ 否

並保證申請標的為自行研發且絕無侵犯他人專利、著作等相關智慧財產權，且填報資料正確無誤。

此致

經 濟 部 中 小 企 業 處

申請企業印鑑：_____ 負責人印鑑：_____

中華民國**100**年____月____日

※ 得獎企業若經查證有違反申請須知規定或不實陳述者，將追繳其獎狀及獎助金，且應負法律責任。

※ 申請本獎勵之企業有提供相關佐證資料以供審查之義務。

※ 得獎企業有配合編製專輯及參加相關活動之義務。

本切結書中需打☑處因牽涉獎勵方式不同(請參考申請須知三、獎勵方式)，請務必確實填列。

申請資料查核表

項目	項次	檢核資料	檢核確認	備註
申請書內容	**01**	申請企業基本資料(表 **1**)	V	
	02	申請獎勵標的資料說明(表 **2-1~2-4**)	V	
	03	申請獎勵標的獲得/申請國內外專利權之紀錄(表 **2-5**)	V	需檢附相關證明文件
	04	申請獎勵標的得獎、認證等之紀錄(表 **2-6**)	V	需檢附相關證明文件
	05	申請獎勵標的之創新性(表 **3-1**)	V	
	06	申請獎勵標的之實用性(表 **3-2**)	V	
	07	申請獎勵標的之國內外競爭力(表 **3-3**)	V	
	08	申請企業目前及中長期研發構想及營運(表 **3-4**)	V	
	09	企業組織圖(表 **3-5**)	V	
	10	企業最近 **3** 年之整體研發創新概況(表 **4**)	V	
	11	企業近 **5** 年申請政府補助及運用國內研發資源之紀錄(表 **5**)	V	
	12	切結書(表 **6**)	V	需加蓋公司大、小章
應檢附相關文件	**01**	公司登記資料影本 財政部稅務入口網 http://www.etax.nat.gov.tw	V	可逕行上網查詢列印
	02	工廠登記證明文件影本 (小型工廠者需檢附切結書)		服務業免附
	03	國內外專利證明或申請相關文件	V	
	04	其他相關證明文件影本如獲獎紀錄、標準、認證、著作權	V	SGS
	05	政府補助及運用國內研發資源相關文件	V	
	06	商業化或量產證明影本	V	第一筆出貨單
	07	**99** 年 **1~12** 月勞保局核發之「勞工保險局保險費繳款單及明細表」影本	V	以資本額或營業額認定之中小企業免附
	08	**99** 年度營利事業所得稅結算申報書影本 (含資產負債表及損益表)	V	務必於 6/15 前繳交
	09	其他相關資料(相片、型錄等)	V	組織圖、合作意願書、型錄、活動手冊、光碟片

註:請逐項確認並勾選於檢核確認欄位